

# IP22

## 주요 특징

TechRes® IP22 제품은 반도체 제조 공정인 에칭, 에싱, 그리고 CVD 등의 DRY 공정에서 발생하는 화학 물질과  $\text{ClF}_3$  같은 크리닝 개스에 대하여 탁월한 저항력을 나타내며 산소 및 불소 플라즈마 환경에 적합하도록 설계되었습니다. 이 제품은 플라즈마 반발성에 낮은 무게 손실을 가지며, 메탈성분을 최소화 하여 엄격한 쉘의 신뢰성과 오염관리를 요하는 다양한 종류의 반도체 장비에 적용할 수 있습니다. 내열성으로는 최고 적용온도는 220°C이나 선택된 유체의 온도는 별도로 고려하여야 합니다.

## Typical Physical properties

Color	Black
100% Modulus <sup>a</sup> , Mpa	6.3
Tensile Strength <sup>a</sup> , Mpa	16.6
Elongation at break <sup>a</sup> , %	166
Hardness Shore A <sup>b</sup>	77
Compression Set <sup>c</sup> , % (48 hr at 200°C)	20
Max. Continuous Service Temperature, °C	220

<sup>a</sup> ASTM D412(dumbbell test specimens)

<sup>b</sup> ASTM D2240(pellet test specimens)

<sup>c</sup> ASTM D395B(AS568 #214 O-Ring test specimens)



PRODUCT INFORMATION

## 기능 및 이점

우수한 플라즈마 저항성 / 낮은 아웃 가스 / 낮은 컴프레션 셋 / 우수한 내 화학성 / 안정적인 내열성

## 적용 분야

Chamber lip seals / Bonded slit valve door seals / Bonded Gate valve door seals / Gas inlet seals